

システムLSIで新たな付加価値創造

最新トピックス

より一層の機能向上、小型化、低消費電力化などエレクトロニクス製品に対する市場ニーズはとまどるところを知らない。

また通信、コンピュータ、AV機器など異業種間の技術の融合も求められている。このため、半導体LSIの設計スピードが、毎年十一月に

VS-アライアンス

IPの標準仕様を目指す

川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

非営利目的のワールドワイドな組織「VS-アライアンス」が設立された。七月三十一日現在、全世界四十社、団体、このうち日本からは三十三社、団体が参加し、標準インターフェイス仕様の定義、開発、検証、試験、その普及を目的としている。標準仕様に盛り込まれるのは、システムフォーメット、テスト



上田氏

上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

半導体総合 広告特集

△次ページへ続く△

日米でデータを交換 チップ、中身で差別化 機能統合がトレンド

上田氏 西村氏 桜井氏



西村氏

西村氏 上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

西村氏 上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

西村氏 上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

西村氏 上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

西村氏 上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ

西村氏 上田氏 川島が世界の発展に欠かれないものになってきた。これらに対応するため、二つのシリコンチップ



桜井氏

従来半導体は、メモリやアナログ制御、ASIC(特定用途向けIC)という製品分野別にビジネスが行われてきた。しかし、ユーザー側からワンチップ化してアプリケーションコストを下げたいというニーズが